



广东风华高新科技股份有限公司

GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD.

中国 肇庆 风华路 18 号

18th Fenghua Road, Zhaoqing, Guangdong, China

关于下达 2019 年度新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室开放课题基金资助项目的通知

根据“客观公正、平等竞争、择优支持”的评审原则，经申请人申报、专家评审，新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室决定对“氮气气氛烧结用有机载体的研究”等 10 项课题予以资助（见附件）。

新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室将与各项目负责人签订具体的开放课题合同，确保项目按节点目标完成。

新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室

2019 年 8 月 8 日



附件：2019 年度新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室开放课题基金资助名单（见下页）



广东风华高新科技股份有限公司

GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD.

中国 肇庆 风华路 18 号

18th Fenghua Road, Zhaoqing, Guangdong, China

附件:

2019 年度新型电子元器件关键材料与工艺国家重点

实验室开放课题基金资助名单

序号	课题项目名称	课题类别	申请人	申报单位	资助金额
1	氮气气氛烧结用有机载体的研究	指定命题开放课题	钱丽颖	华南理工大学	20
2	(ba1-xcax)tio3 粉体的可控合成及对 x7r 材料和 mlcc 的影响机制		常云飞	哈尔滨工业大学	25
3	长石基低介超低损耗 ltcc 瓷粉研制		雷文	华中科技大学	25
4	低 tcr 氮化钽薄膜的制备与研究		李海鸥	桂林电子科技大学	25
5	低阻钼银浆料用无铅玻璃粘结剂的配方设计及研发		刘小磐	湖南大学	20
6	辊印浆料有机体系开发		李路海	北京印刷学院	25
7	高稳定性低电阻率高 b 值 ntc 热敏电阻的制备研究	自主命题开放课题	郑志平	华中科技大学	10
8	印刷电子用高性能电极材料研究		宁洪龙	华南理工大学	10
9	氧化锌压敏陶瓷微波烧结工艺研究		王慧	华南理工大学	10
10	三维硅基电容器介质薄膜电极研究		张冠华	湖南大学	10